

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年4月23日
【会社名】	シャープ株式会社
【英訳名】	Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 沖津 雅浩
【本店の所在の場所】	堺市堺区匠町1番地
【電話番号】	(072)282-1221（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 証券財務グループ 部長 中尾 佳永
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区匠町1番地
【電話番号】	(072)282-1221（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 証券財務グループ 部長 中尾 佳永
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は、2025年7月1日（予定）を効力発生日として当社の子会社であるシャープ福山レーザー株式会社(以下、「SFL社」といいます。)の事業に関連した当社保有の権利義務について、SFL社に会社分割（吸収分割）により承継させること（以下、「本件吸収分割」といいます。）を下記のとおり決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（１）当該吸収分割承継会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商 号	シャープ福山レーザー株式会社 (以下、SFL社といいます)
本 店 の 所 在 地	広島県福山市大門町旭1番地
代 表 者 の 氏 名	蔡 正 茂
資 本 金 の 額	30百万円
純 資 産 の 額	10,539百万円
総 資 産 の 額	21,860百万円
事 業 の 内 容	半導体レーザーの企画／開発／生産／販売、半導体及び半導体応用デバイスの開発／製造／販売 及びファウンドリーサービス

最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

(単位：百万円)

決 算 期	2022年３月期	2023年３月期	2024年３月期
売 上 高	36,500	37,173	33,029
営 業 利 益	918	-2,063	607
経 常 利 益	845	-2,337	1,500
当 期 純 利 益	771	-2,409	1,251

(注) SFL社は連結決算を行っていないため、単体での数値です。

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
シャープ株式会社	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	同社は当社100%出資の連結子会社であります。
人的関係	当社は、当該会社に対して当社社員が出向しております。
取引関係	当社は、当該会社との間で、半導体レーザー、半導体及び半導体応用デバイスの取引があります。

（２）当該吸収分割の目的

当社中期経営方針で示したアセットライト化の方針に沿って、当社親会社であるHon Hai Precision Industry Co. Ltd.のグループ会社へSFL社株式譲渡の検討を進めており、その事前再編としてSFL社の事業に関して当社が有する権利義務を吸収分割によりSFLへ承継することと致しました。

（３）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

会社分割の方法

当社を分割会社とし、当社の100%子会社であるSFL社を承継会社とした吸収分割方式です。

吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、SFL社から当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付はありません。

その他の吸収分割契約の内容

）本吸収分割の日程

決定日 2025年4月23日

契約締結日 2025年4月23日
実施予定日(効力発生日) 2025年7月1日(予定)

注) 当吸収分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割、SFL社においては会社法796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、株主総会の決議を経ずに実施する予定です。

) 本吸収分割により増資する資本金

本吸収分割に際して当社並びにSFL社の資本金の増減はありません。

) 本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権に関する取扱いに変更はありません。

) 承継会社が承継する権利義務

本事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務を当社とSFL社との間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

(4) 本吸収分割の係る割当ての内容の算定根拠

本吸収分割に際して、SFL社から当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付はありません。

(5) 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商 号	シャープ福山レーザー株式会社
本 店 の 所 在 地	広島県福山市大門町旭1番地
代 表 者 の 氏 名	蔡 正 茂
資 本 金 の 額	30百万円
純 資 産 の 額	21,424百万円
総 資 産 の 額	35,281百万円
事 業 の 内 容	半導体レーザーの企画/開発/生産/販売、半導体及び半導体応用デバイスの開発/製造/販売 及びファウンドリーサービス

以 上